

小型手动划片机 SYJ-DS100

技术规格书



SYJ-DS100 是一款小型的手动划片机，金刚石刀头可用于划切单晶片，如硅片、蓝宝石等。划切压力通过一个弹簧来调节，最大可划切的样品长度为 100mm。

技术参数：

设备名称型号	小型手动划片机 SYJ-DS100
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 可切样品厚度：0.05-1mm • 压力调整范围：0-50N • 可切样品最大长度：110mm • 切割轮厚度：0.65mm
切割程序	<ul style="list-style-type: none"> • 调整轮式切割机的高度 • 调节弹簧的压力 • 固定基片 • 划线 • 掰开基片
更换金刚石划线器	<ol style="list-style-type: none"> 1、将金刚石划片高度调节盘和弹簧压力调节盘旋转到原点“0” 2、将滑块移动到金刚石划片更换位置并拆卸导杆 3、把把手向左转动 90° 4、用内六角扳手松开螺丝，取出金刚石划线器 5、安装新的金刚石划线器并拧紧螺丝 6、将手柄放回划片位置，并设置导杆

<p>可选</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 可选购其他尺寸的划片机，详情请咨询我公司销售部门 • 图一可切割样品最大长度为：200mm，图二可切割样品最大长度为：300mm  <p>图一 图二</p>
<p>设备外形尺寸</p>	<p>210mm (L) *210mm (W) *140mm (H)</p> 
<p>重量</p>	<p>约 1.4KG</p>
<p>质保</p>	<p>一年保质期，终身维护</p>
<p>注意事项</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 轮式切割刀使用时会磨损，当轮式切割刀变钝及时更换。 • 为避免弹簧退化，在存放时，请将弹簧压力旋钮拨到初始位置 0。 • 使用本产品前，请擦拭滑动装置导杆，导杆上定期补充润滑脂。 • 如需拆卸安装产品请参考说明书，如无必要，避免频繁拆装。